

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁷

G09F 3/02

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 00254277.3

[45]授权公告日 2001年7月11日

[11]授权公告号 CN 2439076Y

[22]申请日 2000.9.21 [24]颁证日 2001.6.16

[73]专利权人 刘建明

地址 300150 天津市王串场 24 段(环盛里)21
门 108 号

[72]设计人 刘建明

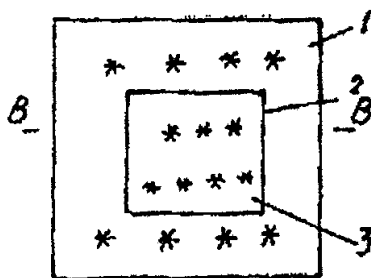
[21]申请号 00254277.3

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

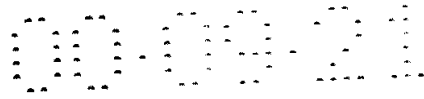
[54]实用新型名称 防伪标签

[57]摘要

本实用新型是涉及识别商品真假的一种标识制品。载体为绝缘材料制品,其上装有半导体芯片。可标识的信息内容十分广泛,均以某种数据格式如加密运算规则进行编码、存贮在芯片之中,需进行解码运算后读取数据使信息还原,才能得知其内容,难以破译,保密性强;标签中的内容很难被仿制、伪造。



I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

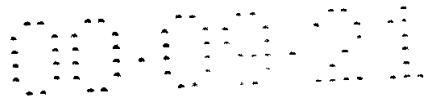


权 利 要 求 书

1、一种防伪标签，包括载体，其特征在于：载体为绝缘材料制品，其上装有半导体芯片。

2、如权利要求1所述的防伪标签，其特征在于：半导体芯片表面设有通用标签。

3、如权利要求1、2所述的防伪标签，其特征在于：半导体芯片嵌装在载体中。



说明书

防伪标签

本实用新型是涉及识别商品真假的一种标识制品。

用于识别商品真假的防伪标签，有在纸、塑料薄膜等载体上印刷精美、着五颜六色字符和图案的普通标签，也有用光学原理或温敏效应等物理化学方法在载体上制成的各种特殊标签。现有技术的不足之处主要在于：它们都是平面型制品，标识内容—字符、图案等在一定程度上直观可见，保密性差；标签本身容易仿制、伪造。

本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足之处，而提供一种保密性好，难以破译和仿造的防伪标签产品。

可采取以下的技术方案实现目的。

防伪标签，包括载体，但载体为绝缘材料制品，其上装有半导体芯片。

在满足上述结构要求的前提下，至于防伪标签整体、各功能部分、每个零部构件的具体结构形式、大小，构件间的连接、固定方式，位置关系等，均可根据使用需要，酌情设定，它们都能实现目的，保证本标签的使用性能和效果。

本技术方案相对现有技术具有如下优点和效果：

可标识的信息内容十分广泛，如常用的商品名称、规格型号、生产厂商、出厂日期、产品批号等或其它，均以某种数据格式如加密运算规则进行编码、存贮在芯片之中，需进行解码运算后读取数据、使信息还原，才能得知其内容，难以破译，保密性强；标签中的内容很难被仿制、伪造。

结合附图、实施方式对本技术方案的内容作进一步详述。

图1是防伪标签的一种结构示意图；

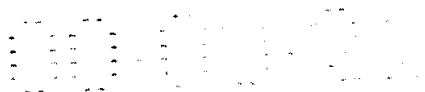


图2、3是图1的A-A剖视图；

图4是防伪标签的另一种结构示意图；

图5、6是图4的B-B剖视图。

图中‘*’示意可见的字符、图形之类。

实施例1、防伪标签，包括载体，载体1为绝缘材料平面制品，其上装有半导体芯片2。载体可采用常规塑料、PVC、纸片等绝缘材料构成，在其上可标注字符、图案之类可见内容。半导体芯片可以是普通存储器，也可以是数据处理器或门逻辑电路等，若采用多密级编码技术则更难破译和伪造；其识别器可采用现有的相应装置实现。如附图1、2所示。

实施例2、防伪标签，在实施例1的基础上，半导体芯片2表面设有通用标签3。通用标签既可以是纸、塑料薄膜等印刷精美、着五颜六色字符和图案的普通标签、也可以是用光学原理或温敏效应等物理化学方法制成的各种特殊标签，它可以只复盖半导体芯片，也可以连载体一同复盖；其它结构均与实施例1相同。如附图4、5所示。

实施例3、防伪标签，半导体芯片2嵌装在载体1中。即载体为立体制品，它可由一绝缘平面件与一绝缘框件粘接构成，也可以是带凹槽的整体制品如纸浆、塑料、PVC注塑件，芯片嵌装在框或凹槽之中；其它结构与实施例1相同。如附图1、3所示。

实施例4、防伪标签，半导体芯片2嵌装在载体1中，芯片2表面设有通用标签3。其它结构与上述实施例相关部分相同。如附图4、6所示。

附图所示实施例的使用性能、使用效果为佳。



说明书附图

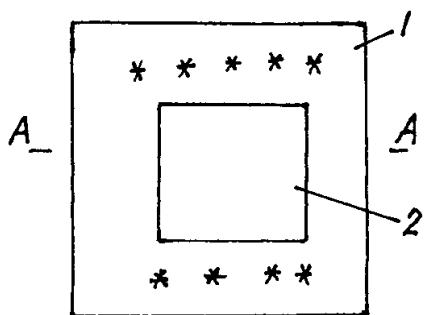


图1

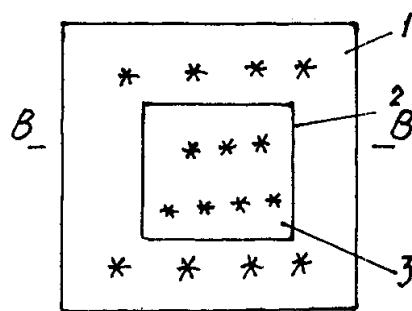


图4

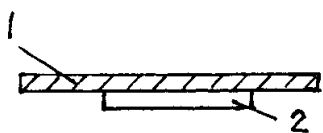


图2

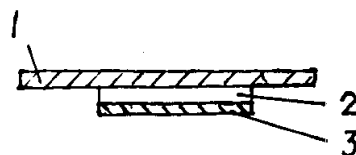


图5

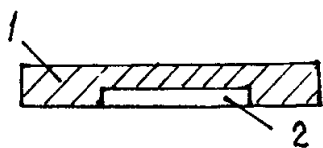


图3

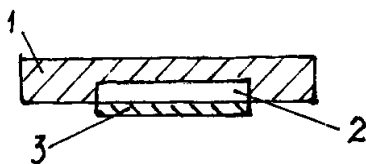


图6